证券代码：300331　　证券简称：苏大维格

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观　☑电话会议 ☐其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司；富国基金；嘉实基金；交银施罗德基金；东方阿尔法基金；安信基金；兴业证券；国联安基金；华泰保兴基金；人保资产；海通证券；安联保险资管；光大证券；申万菱信基金；东方基金；开源证券；宁泉资产；中邮保险资管；平安养老；兴业基金；华安基金；中新融创资本；正圆投资；融信汇资本；IDG资本；恒生前海基金；东方证券（自营）；野村东方国际证券资管部；圆信永丰基金；淳厚基金；睿远基金；中航基金；太保资产；国海富兰克林基金；新思哲投资；富安达基金等160余家机构及部分个人投资者
时间	2026 年 11 月 5 日 16:30-17:00
地点	采用线上电话会形式进行
公司接待人员姓名	董事、副总裁：蒋林 董事会秘书：王志
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 11 月 5 日 16:30-17:00 采用线上电话会的形式接待部分机构与个人投资者调研，公司董事、副总裁蒋林先生首先就公司第三季度业绩做了简要解读，并就投资者关心的问题进行了回复： **1、2026 年前三季度公司整体经营情况如何？** 答：2026 年前三季度，公司实现营业收入 15.20 亿元，实现归母净利润 7,425.50 万元，同比增长 108.11%。其中，年初纳入公司合并报表的半导体检测设备控股子公司维普半导体在前三季度贡献了较高的利

	润，对上市公司利润形成较强的正向支撑；反光材料业务子公司华日升前三季度亏损幅度同比大幅增加，对公司利润产生了较大影响；传统 3D 印材业务因烟草和白酒行业需求疲软，收入和利润同比下滑；消费电子和汽车领域微纳新材料业务相关产品结构持续优化，利润水平同比有所改善。 **2、维普 2026 年前三季度经营、订单和盈利能力如何？** 答：维普半导体 2026 年前三季度保持了较好的同比和环比增长趋势。维普半导体目前收入主要来源于 Storm3000 系列的成熟产品，最新的 Storm5000 系列在头部客户的验证进展顺利，若后续头部客户成功验收，有望带动维普半导体业绩进一步提升。除上述有图形掩膜版缺陷检测设备外，维普半导体在掩模基板检测设备及有图形晶圆检测设备领域也在进行相关高制程新产品的开发，进展顺利。 **3、维普 Storm 系列的制程、国内地位和技术进展如何？** 答：目前，维普半导体核心产品为 Storm3000 和 Storm5000 系列掩模缺陷检测设备，其中 Storm3000 为成熟产品及当前主要收入来源，Storm5000 为最新产品，对标科磊 5XX 系列产品。全球掩膜版缺陷检测由美国科磊（KLA）主导，日本 Lasertec 紧随其后。维普半导体是国内极少数实现掩膜版图形缺陷检测设备量产的企业，已进入国内头部逻辑芯片晶圆厂商量产线、实现了国外头部客户的验收和复购，并已向中国台湾头部客户发货。目前国内掩膜版检测设备国产化率较低，为个位数，公司目标是未来实现该领域较大份额的国产化替代。 **4、维普净利率水平是否可持续？** 答：目前维普半导体净利润率离全球头部厂商仍有一定差距，维普半导体后期会通过检测设备的迭代升级维持其盈利能力。例如 Storm5000 等中高端产品的放量，同时，维普半导体也在开发更高端的面向先进制程的 Storm6000 产品，以期进一步提升盈利能力。 **5、维普客户海外客户验证进展如何？** 答：维普半导体韩国客户已在 2026 年第二季度实现验收并贡献较大收入；中国台湾客户已在 2026 年第三季度发货。

	6、华日升出售进展如何？ 答：华日升 100%股权公开挂牌转让事项于 2026 年 10 月 19 日获公司股东会审议通过，并于 2026 年 10 月 30 日正式在苏州产权交易中心挂牌，若无第三方参与摘牌，公司控股股东、实际控制人陈林森先生或其关联方将在后续轮次中摘牌。华日升 100%股权挂牌转让交易包括股权交易对价和相关债权的回收，交易完成后可大幅改善上市公司现金流与整体资产质量，为上市公司在半导体精密光学设备与器件领域的战略布局提供有力支撑。根据公司战略发展规划，公司重点围绕有图形的暗场检测和先进封装检测厂商需求做产业布局和资金投入，并希望通过与维普半导体的产业协同，顺利将公司直写光刻技术与设备推广应用于半导体领域。 **7、公司在先进封装光刻和无掩模/数字光刻方面的布局进展如何？** 答：公司在晶圆级和面板级先进封装光刻领域进行了重点投入与布局，主要为 W 型（wafer 型）和 P 型（面板级）直写光刻设备。其中 W 型正与客户对接测试，P 型样机已完成。未来，公司将结合维普半导体在检测环节的技术能力，围绕先进封装检测与直写光刻协同布局，探索更多产业化路径。当前，公司在该领域的布局尚未实现量产收入。 **8、维普掩模板检测设备当前国内国产化率和技术壁垒？** 答：技术壁垒方面，掩膜版是晶圆制造的“模具”，对缺陷零容忍，必须达到 100%缺陷检出，漏检会导致缺陷批量复制到晶圆，导致整批晶圆报废，因此技术要求高，其客户对掩模检测设备的验证壁垒很高。维普半导体掩模检测设备成功进入国内外头部厂商，一方面因全球科技竞争和国际形势的变化，另一方面因国家在关键领域提出的国产化要求，给了国产设备验证机会，若缺少上述条件，下游头部厂商和海外客户很难给予新进入者机会。技术层面，掩膜版缺陷检测设备属于高门槛、高上限的产品，不光要进行 die-to-die 的图形互比，掩膜版检测还要进行 DB（Die-to-Database）检测，是在纳米级尺度下快速提取掩膜版图形，并与电脑中的设计数据库进行比对，数据量非常大、速度要求非常快。同时，光刻的邻近效应和衍射效应会使得刻出图形相较设计图形产

	生形变，缺陷检测过程需要快速判断形变图形的功能一致性，对算法和硬件协同要求极高；再叠加 100%缺陷抓取率要求，掩模缺陷检测难度进一步提升。
附件清单	无
日期	2026 年 11 月 5 日